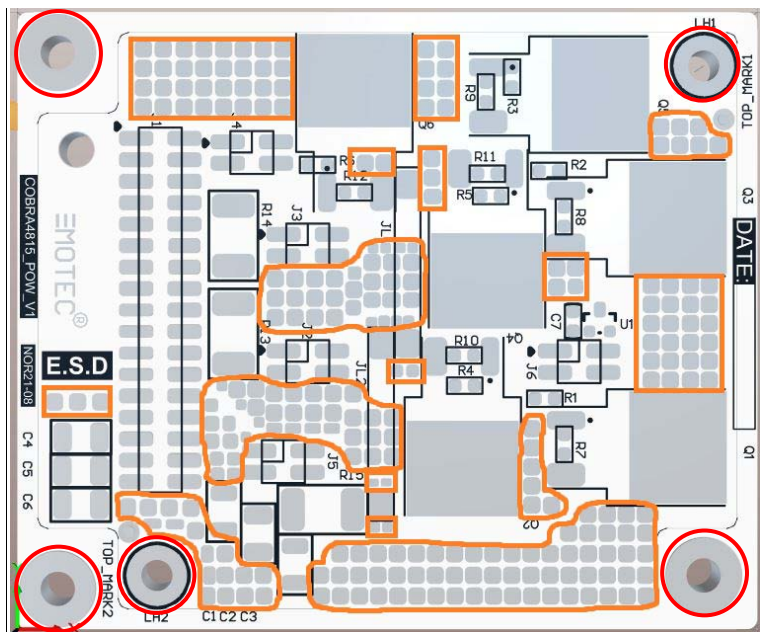


PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	COBRA4815_POW_V1	焊接	QM03321082701	V1	1/1	20210827

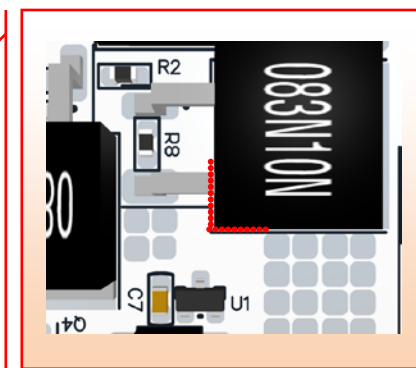
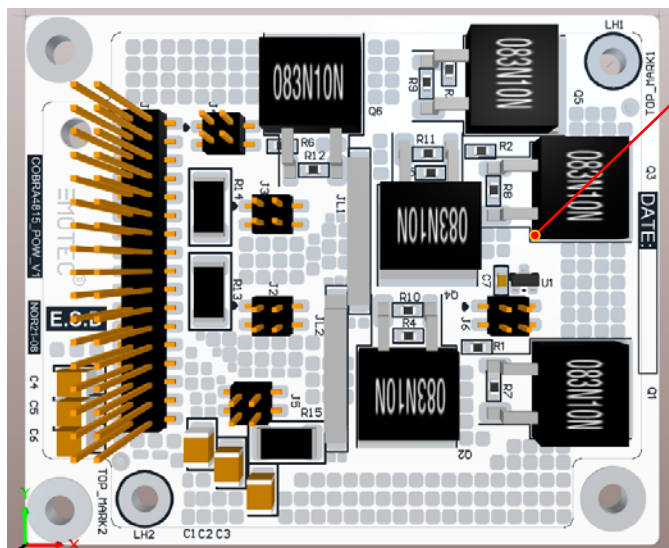
- R13, R14 位置分别叠焊 3 个 R010 电阻 (2510 封装), R15 位置叠焊 2 个 R010 电阻 (2510 封装)
- 功率走线加锡: 下图橙色标注位置 (即除元件焊盘外, 所有裸露焊盘 [露铜位置] 进行加锡)



- 框内 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm
- 框内固定孔焊盘 (PAD) 及 MARK 点 **不接受沾锡**

3. 功率管焊接要求

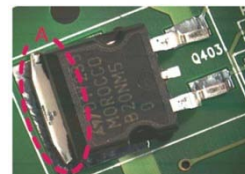
1) 功率管 Q1~Q6 共计 6 个 (D2-PAK 封装的管子) 焊接, 要求功率管边角 (红线标识) 与 PCB 的黑色丝印限位框直角对齐, 严格按照下图的标识定位焊接;



※功率管焊接定位:
上图的功率管边角 (红线标识) 与 PCB 的黑色丝印直角限位框对齐

2) 功率管焊接**偏移**接受标准:

- 散热面端子 (A) 的侧面偏移不大于端子宽度的 3% (约 0.3mm, 右图为焊接不良图片)
- 散热面末端端子连接宽度在与焊盘接触区域有 100% 润湿



3) 功率板为铝基板, **严禁**元件冷焊及虚焊

- 所有排针排母焊接, 需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	